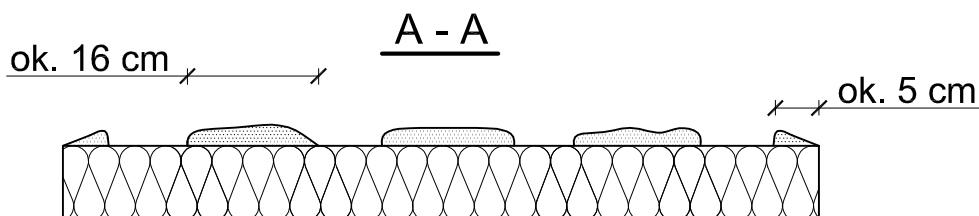
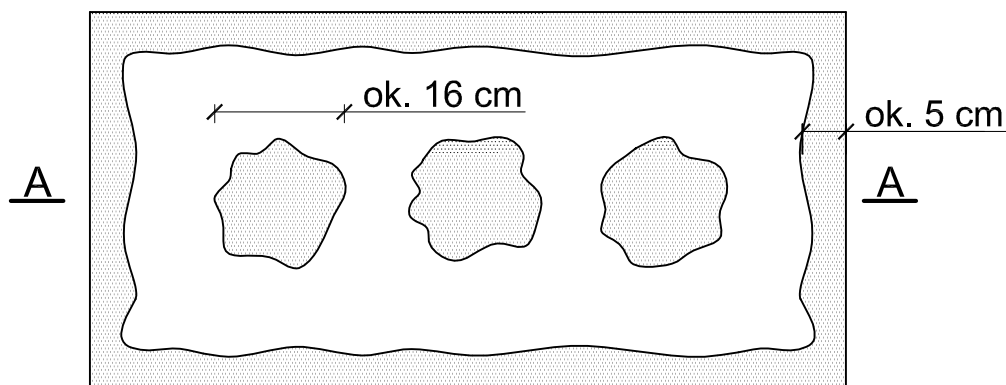
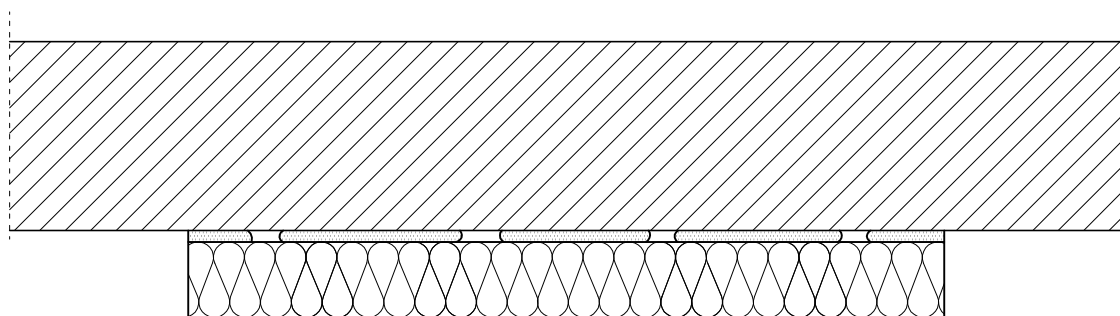


## Detal 1.1

## Sposób klejenia płyt izolacji termicznej.



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% \geq 40 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia  
płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej  
przylegająca do ściany

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40 % efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

|                                                                                                                                                              |                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| "RYWAŁ"PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>RYSZARD WALCZAK                                                                                                               |                                          | NR                         |
| 31-977 KRAKÓW OS. SZKOLNE 22                                                                                                                                 |                                          | 1                          |
| Tytuł: Projekt termomodernizacji budynku Szkoły<br>Podstawowej nr 2<br>Sposób klejenia płyt izolacji termicznej<br>Adres: 30-724 Kraków ul. Górczyńskiego 44 |                                          | Branża:<br>ARCHITEKTURA    |
| Opracował:                                                                                                                                                   | mgr inż. Ryszard Walczak                 | upr. bud. UAN 117/86       |
| Projektował:                                                                                                                                                 | mgr inż. arch. Bożena Bończa Tomaszewska | upr. bud. 1043/94          |
| Sprawił:                                                                                                                                                     | mgr inż. arch. Grażyna Kuźniar           | upr. bud. UAN.1-7342/90/98 |

Data wykonania: 17 czerwiec 2013 r.